Title (en)

Printed circuit board

Title (de)

Leiterplatte

Title (fr)

Plaquette à circuit imprimé

Publication

EP 0977220 A1 20000202 (DE)

Application

EP 99108119 A 19990424

Priority

DE 19834375 A 19980730

Abstract (en)

The circuit board has a surface with at least two contact areas and a spring-elastic contact body (4) for actuation by a switching pin or cam, whereby the contact body produces a contact reset voltage and short circuits the contact areas with a contact arm. The contact body is a hairpin spring (7) that protrudes through a circuit board opening (8) so that its two arms (9,10) are approximately parallel to the circuit board surfaces. The arm (9) on the contact area side of the circuit board is longer than the other arm (10) and has contact bulges (12,13) at the end and in the middle. The shorter arm ends between the bulges and has a supporting bulge (14) and hook section (15) on its end. The hook section locks into a hole in the circuit board.

Abstract (de)

Eine bekannte Leiterplatte läßt keinen Transport von Baugruppenteilen zu, da die Einzelteile nur lose zusammengesteckt sind, d. h. verlierbar sind. Hiergegen ist vorgesehen, daß der Kontaktkörper (4) als Haarnadelfeder (7) geformt ist und durch eine Leiterplattenöffnung (8) so hindurchragt, daß seine zwei Schenkel (9, 10) in etwa parallel zu den Leiterplattenoberflächen (11) ausgerichtet sind, daß der eine Schenkel (9) auf der Kontaktflächenseite der Leiterplatte (1) länger ist als der andere Schenkel (10) und Kontaktauswölbungen (12, 13) am Schenkelende und an der Schenkelmitte aufweist, daß der kürzere Schenkel (10) zwischen den beiden Kontaktauswölbungen (12, 13) endet und am Schenkelende eine Auflageauswölbung (14) und einen Hakenansatz (15) aufweist, wobei der Hakenansatz (15) in eine weitere Leiterplattenöffnung (16) hineinragt und in dieser arretiert ist. Die neue Leiterplatte ist leicht zu fertigen. <IMAGE>

IPC 1-7

H01H 1/26

IPC 8 full level

H01H 1/26 (2006.01); **H01H 1/58** (2006.01)

CPC (source: EP)

H01H 1/5805 (2013.01); H01H 1/26 (2013.01)

Citation (search report)

- [A] DE 19642808 C1 19980423 - SIEDLE & SOEHNE S [DE]
- [DA] DE 4330576 C1 19941110 - PREH ELEKTRO FEINMECHANIK [DE]

Designated contracting state (EPC)

DE ES FR GB

DOCDB simple family (publication)

DE 19834375 C1 19991209; DE 59904261 D1 20030320; EP 0977220 A1 20000202; EP 0977220 B1 20030212; ES 2189307 T3 20030701

DOCDB simple family (application)

DE 19834375 A 19980730; DE 59904261 T 19990424; EP 99108119 A 19990424; ES 99108119 T 19990424